

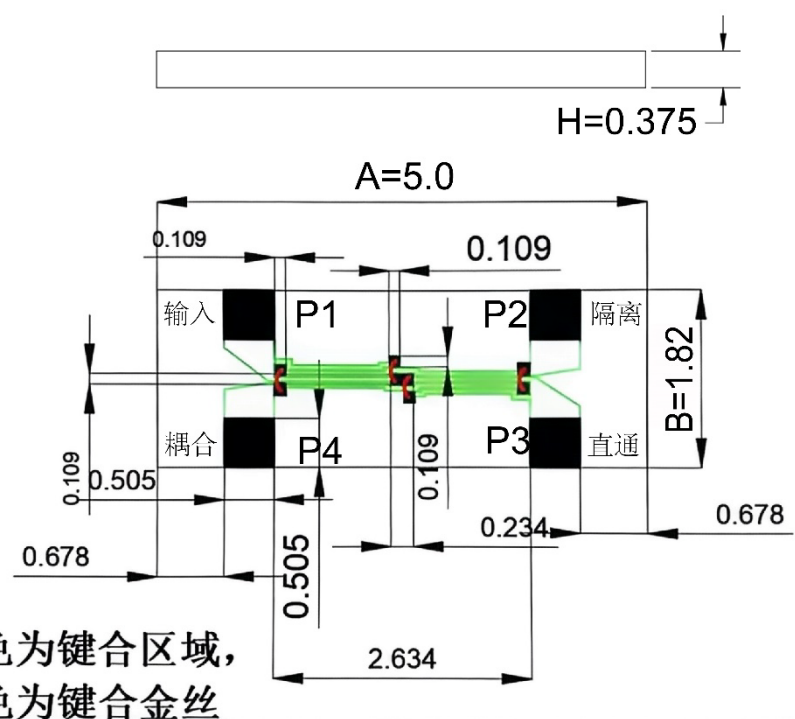
技术指标（常温+25°C）

序号	项目	技术指标
1-1	产品名称	薄膜微带键合电桥
1-2	产品型号	HC0618WB
1-3	工作频率	6.0~18.0GHz
1-4	耦合度	3.0±1.5dB
1-5	插入损耗	≤1.5dB
1-6	隔离度	≥18dB
1-7	带内驻波比	≤1.8
1-8	输入输出阻抗	50 欧姆
1-9	输出安装方式	键合
1-10	产品尺寸	5.0mm*1.82mm*0.375mm

环境参数

2-1	工作温度	-45°C~+85°C
2-2	存储温度	-55°C~+125°C
2-3	最高输入功率	30W

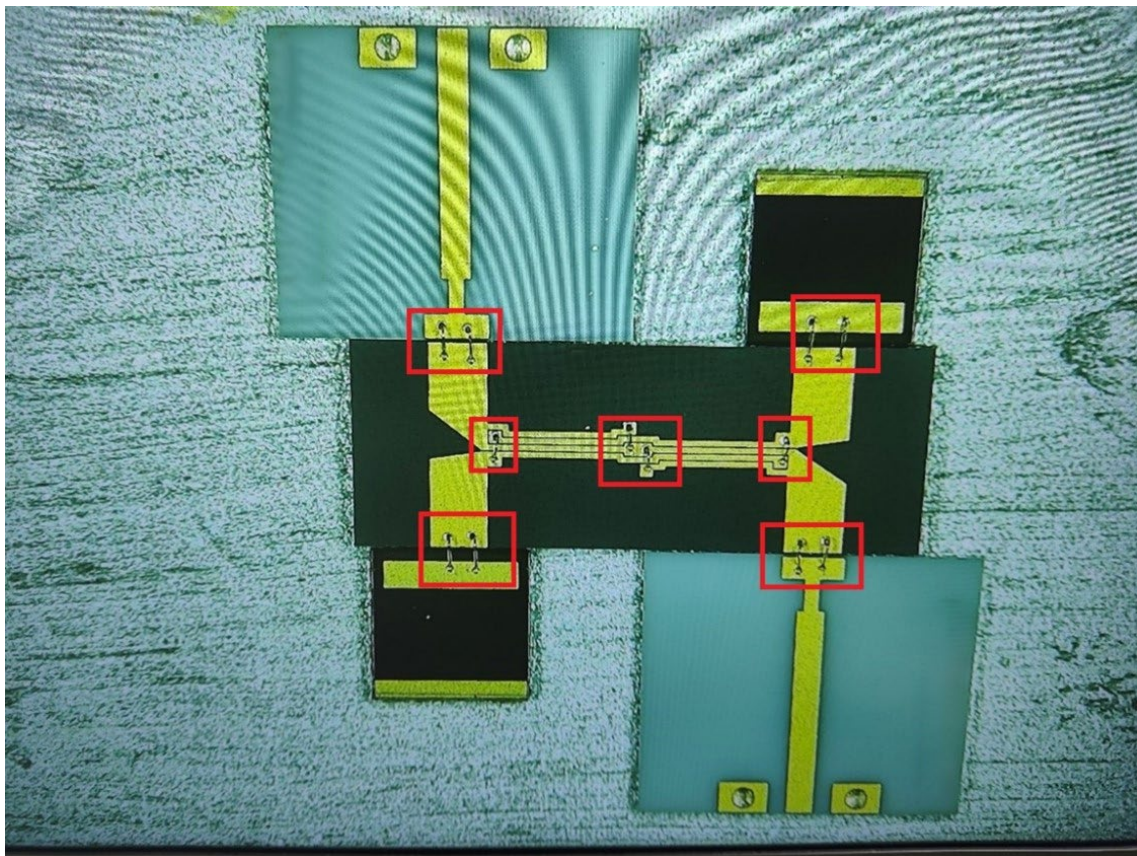
外形尺寸

3-1	外形尺寸	见下图（A、B 外形公差： ±0.1mm）
 黑色为键合区域， 红色为键合金丝		
3-2	标识尺寸	A: 5.0mm B: 1.82mm H:0.375mm （图中尺寸单位为 mm，A、B 外形公差： ±0.1mm）
3-3	基板材料	ALN
3-4	表面处理	镀金

版本状态

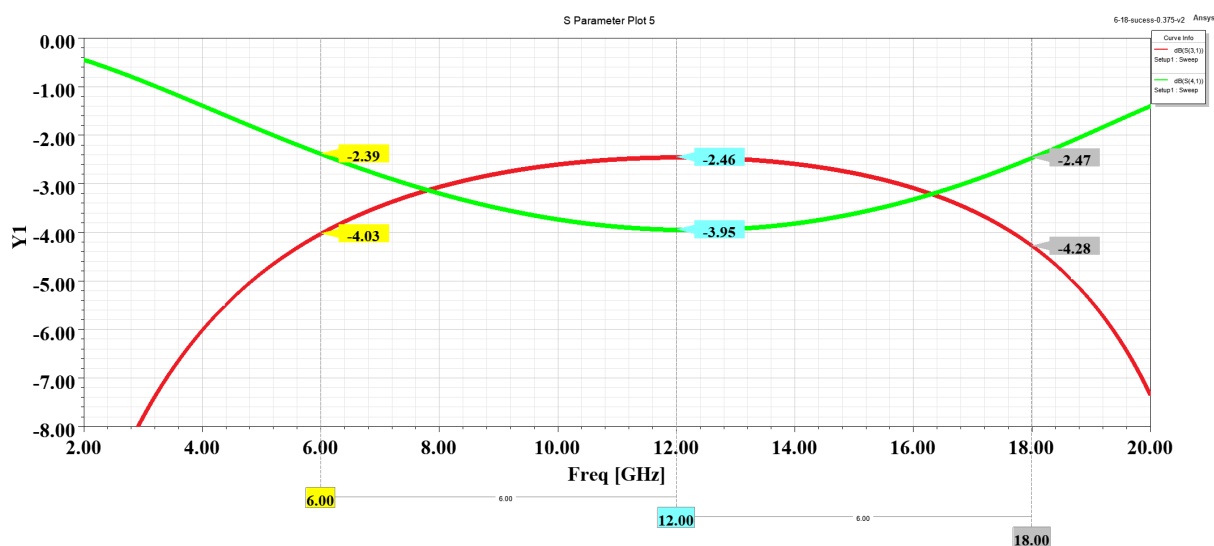
版本号	版本日期	文档状态
A1.0	20260513	✓

金丝键合实际效果图:

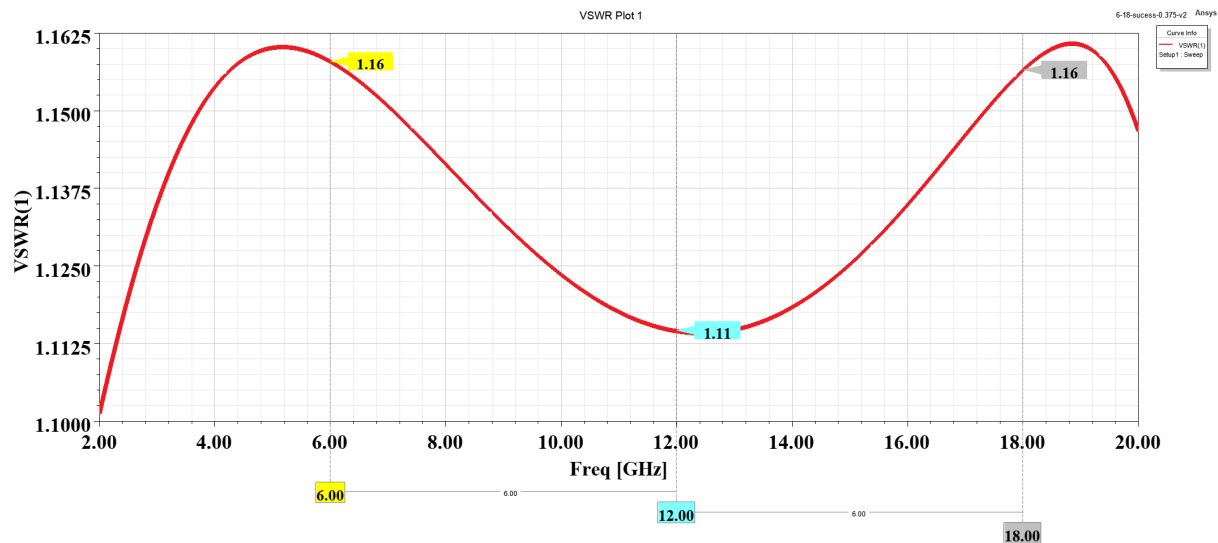


仿真曲线:

a. 耦合度&插入损耗 (6-18GHz)



b.驻波 (6-18GHz)



c.隔离度 (6-18GHz)

